



1. Все измерения осуществлены от базы В.
2. Тектолит толщиной 1.5мм.
3. SMD компоненты можно устанавливать с обеих сторон.
4. Разъём разводится на верхней стороне, запаивается на нижней. Положение и угол поворота разъёма зависят от тактиже параметров ответной части на нижней плате.
5. Крепёжные отверстия диаметром 3мм.
6. По краю отверстия бордюр для головки винта. Его наружный диаметр 7.5мм для головки винта диаметром 7мм.
7. Головка винта может иметь контакт с сигналом GND.
8. Всё свободное пространство залито сигналом GND.
9. Переход сигналов питания на другую сторону, только с помощью группы (не одного) переходных отверстий.
10. По краю платы бордюр шириной около 8мм, на нём с обеих сторон желательно расположить GND.
11. Везде где есть одноимённые полизлы или бордюры питания с двух сторон платы, они прошиваются переходными отверстиями с шагом 10мм. (если это возможно).
12. Если на нижней плате, головка винта контактирует с сигналом AGND, то на верхней плате это отверстие не должно иметь контакта с GND. Потому что стойка межплатного соединения токопроводящая. Это может произойти со стойками C1 и C2, расположенными рядом с аналоговой частью.

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|--|--------|----------|---------|--|
| | | | | | Звуковой синтезатор SND.SYNT.301.DE | | | | |
| | | | | | Плата Клавиатуры | Лист | Масса | Масштаб | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | |
| Разраб. | | | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | | |
| Н.контр. | | | | | ooo "Ремис" | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |